

車載電子製品における小型化・熱対策のための材料特性

日時 2016年1月26日(火) 10:30～16:30 会場 高橋ビルディング (東宝土地(株)) 3F 会議室 東京都千代田区神田神保町2-8 S&T出版株式会社
 受講料 49,800円 (メール案内会員価格) 17,300円 (昼食・資料代を含む)
 (税込) <1名様分の受講料で2名様まで受講できます。>
 ※2名様ご参加は同一会社・法人からの同時申込に限りです。
 ※3名様以上のご参加は、追加1名様あたり10,800円OFFになります。

このセミナーの申込受付は終了しました

メール案内登録(無料)を申し込まれた方にはメール案内会員価格を適用いたします。

講師 松本有弘氏 (株)デンソー 電子基盤技術本部 基盤ハードウェア開発部 担当部長

趣旨

車載電子製品の搭載数が増加し、製品には小型・軽量化が求められています。製品の小型化は、熱マネジメントを難しくします。両者のバランスを取りながら、性能を確保する製品設計とそこに使用される材料特性について、紹介します。

本セミナーで得られる知識

電子製品の小型化と、車載電子製品に求められる長寿命化を両立させる、高放熱小型実装技術について、信頼性の視点での考え方も学びます。

講演詳細

- カーエレクトロニクスの概要
 - クルマ社会を取り巻く課題
 - 環境、安全、快適・利便
- 車載用電子機器と実装技術への要求
 - 信頼性
 - 小型・軽量化
- 小型実装技術と熱設計
 - センサ製品の小型・軽量化
 - ECU製品の小型・軽量化
 - 小型設計と熱マネジメントの重要性
- 熱設計の基礎
 - 熱抵抗
 - 半導体のジャンクション温度
 - 接触熱抵抗
- 電子製品における放熱・実装技術と材料特性
 - 半導体の耐熱性向上
 - ECU製品の放熱設計と回路基板の役割
 - 各社の放熱設計事例
 - 機電一体製品の小型・放熱設計と材料
- インバータにおいて信頼性を向上させる実装技術と材料
 - 小型化と高放熱性の両立の考え方
 - インバータにおける両面放熱構造
 - 高信頼性・高放熱性を実現する実装技術と材料
 - パワーデバイス実装の信頼性確保のポイント
 - 樹脂成型技術
- 将来動向
 - 電子プラットフォームの進展
 - ワイドバンドギャップ半導体の利用と材料特性

セミナー申込用紙

セミナー名：ST160126(車載電子製品における小型化・熱対策のための材料特性と実装技術)

会社・団体名		TEL	
住所 〒		FAX	
① 氏名	部署・役職		
	E-mail		
② 氏名	部署・役職		
	E-mail		
支払方法 <input type="checkbox"/> 振込 <input type="checkbox"/> 当日現金 ※銀行振込の場合は振込予定日を記載ください		月	日
Eメール案内会員登録(無料) ※E-mailアドレスが必須です。 ※右記に✓印をつけてご登録いただくと、この申込からEメール案内会員価格で申込できます。 ※Eメールでセミナー・書籍の最新情報をご案内致します。		Eメール案内(無料)に <input type="checkbox"/> 登録する <input type="checkbox"/> 登録済み	
		通信欄	

※上記ご記入の上、**FAX 03-3261-0238**までお申込みください。

■お申込み方法
必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。または当社ホームページからお申し込みください。

■受付完了のご連絡

受付完了後、3営業日以内に請求書、受講券、会場案内図を郵送いたします。※お申込み後7日以上経っても受講券・請求書がお手元に届かない場合は、弊社までご連絡ください。
 セミナー申し込み後、受講をキャンセルされる場合は、必ず開催日前日から起算して10日前までにご連絡ください。それ以降のご連絡及び、当日欠席の場合、返金はいたしかねますので、代理の方のご出席をお願いいたします。代理の方も出席できない場合は資料の送付で出席に代えさせていただきます。受講料未入金のまま当日ご欠席されてもキャンセルにはなりません。全額請求させていただきますので予めご了承ください。

■お支払

銀行振込にてお願いいたします。
 受講料のご入金は、開催日までお願いいたします。やむなく開催日以降にご入金の場合は、当日現金でお支払またはお申込みの際に振込予定日をご記入ください。銀行振込の場合、領収証の発行はいたしません。

■個人情報の取り扱い

ご記入の個人情報は、商品の発送、事務連絡、ご案内等に使用いたします。